

意法半導體公布新的公司組織架構

- 新的組織架構將提升產品開發創新速度和效率並縮短產品上市時間，以及加強終端市場客戶的關注度
- 公司將重組為兩大產品部門，再分為四個需依法公布財報的子部門
- 公司在所有地區成立專注終端市場應用的行銷部門，以完善現有之業務和行銷組織架構

【臺北訊，2024 年 1 月 11 日】— 服務橫跨多重電子應用領域的全球半導體領導廠商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱 ST；紐約證券交易所代碼：STM）公布新的公司組織架構，這項決定自 2024 年 2 月 5 日起生效。

意法半導體總裁暨執行長 Jean-Marc Chery 表示，「我們正在重組公司產品部門，以進一步加速產品上市時間，提升產品開發創新速度和效率。重組後，我們能夠從廣泛而獨特的產品和技術組合中獲得更多的價值。此外，以終端市場應用為導向的新組織將讓我們更貼近客戶，以完整的系統解決方案提升整體產品組合的能力。這項重組決定是意法半導體推動公司策略重要的一步，符合我們對所有利益關係人承諾的價值主張，亦與我們在 2022 年所設定之業務和財務目標一致。」

ST 將三個產品部調整為兩個，進一步提升產品開發創新速度和效率，加速產品上市時間

新的產品部門分別為：

- 類比、功率與離散元件、MEMS 與感測器產品部（APMS），由意法半導體總裁暨執行委員會成員 Marco Cassis 帶領。
- 微控制器、數位 IC 與射頻產品部（MDRF），則由意法半導體總裁暨執行委員會成員 Remi El-Ouazzane 帶領。

APMS 產品部將涵蓋意法半導體全部類比產品，其中包括車用智慧電源和驅動解決方案；所有功率與離散元件產品線，內含碳化矽產品；MEMS 和感測器。

APMS 產品部將下設兩個需依法公布財報的子部門：類比產品、MEMS 和感測器子產品部（AM&S）；功率與離散子產品部（P&D）。

MDRF 產品部涵蓋意法半導體全部數位 IC 和微控制器，其中包括車用微控制器；射頻（RF）、進階駕駛輔助系統（ADAS）、資訊娛樂晶片。

MDRF 產品部將下設兩個需依法公布財報的子部門：微控制器子產品部（MCU）；數位 IC 與射頻子產品部（D&RF）。

在新組織成立的同時，意法半導體前車用和離散元件產品部（ADG）總裁 Marco Monti 將離職。

為了完善現有之業務與行銷組織架構，意法半導體還將在所有地區設立專注終端市場應用的行銷部門，為客戶提供以意法半導體產品技術組合為主之端到端的系統解決方案。

ST 正在所有經營地區建立一套以終端市場應用為導向之新行銷部門架構。該新組織將隸屬於意法半導體總裁暨執行委員會成員 Jerome Roux 帶領的業務與行銷部。該新應用行銷部門將涵蓋以下四個終端市場：

- 汽車
- 工業電源和能源
- 工業自動化、物聯網和人工智慧
- 個人電子產品、通訊設備和電腦周邊設備

公司目前之區域業務和行銷組織架構將維持不變。

關於意法半導體

意法半導體匯聚超過 5 萬名半導體技術的創造者和製造者，掌握半導體供應鏈和先進的製造設備。做為一家整合元件製造商（IDM），意法半導體與逾 20 萬家客戶與數千個合作夥伴一起研發產品和解決方案，攜手建立生態系統，協助客戶因應挑戰和新機會，滿足世界對於永續發展之更高的需求。意法半導體的技術讓人們出行更智慧，電源和能源管理更高效，物聯網和連接技術的使用更廣泛。意法半導體致力於 2027 年達成碳中和（適用於範圍 1 和範圍 2，以及部分範圍 3）之目標。更多資訊，請瀏覽意法半導體官方網站：www.st.com。